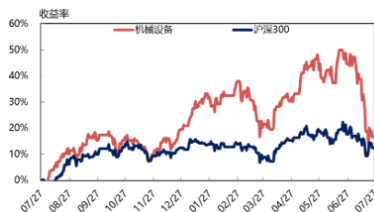


行业及产业

机械设备

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

相关研究

- 《光通信设备行业点评：高速光模块渗透提速，测试设备需求加速释放》2026-07-20
- 《半导体设备行业点评：存储原厂 Capex 上调，看好半导体设备景气》2026-07-13
- 《PCB 设备行业点评：光模块 PCB 扩产潮起，PCB 设备持续景气》2026-07-06
- 《PCB 设备行业点评：TGV 玻璃基板产业化提速，设备环节率先受益》2026-06-29
- 《光通信设备行业点评：CPO 规模化量产渐近，持续看好光通信测试环节》2026-06-22

证券分析师

王凯
S0820524120002
021-32229888-25522
wangkai526@ajzq.com

先进制程设备交期延长，设备零部件景气延续

——半导体设备行业点评

投资要点：

- **事件：设备交付周期延长，全球半导体设备景气持续验证。**7月25日，据韩国媒体 ETNEWS 报道，全球五大半导体设备厂商（AMAT、ASML、LAM、TEL、KLA）主要设备交付周期较此前延长约 50%~100%。部分原本约 6 个月即可交付的设备，目前交付周期已延长至约 12 个月。我们认为，设备交期延长反映全球先进制程及存储扩产带来的设备需求持续旺盛，设备厂商在手订单保持充足，核心设备及上游零部件环节有望持续受益。
- **AI 驱动全球半导体资本开支持续扩张，为设备及零部件需求提供支撑。**
 - 1) AI 需求驱动全球半导体资本开支持续扩张，半导体设备市场有望保持高景气。**根据 SEMI，全球半导体制造设备销售额预计 2026 年达到 1659 亿美元，同比增长 23.2%，并有望于 2028 年进一步增至 2295 亿美元。其中，晶圆制造设备（WFE）仍为行业增长的主要动力，2026 年市场规模预计达 1439 亿美元，同比增长 23.1%，主要受 HBM 相关 DRAM 扩产及先进逻辑制程投资拉动，2028 年市场规模有望突破 2000 亿美元。与此同时，AI 芯片复杂度提升及先进封装加速渗透带动后道设备需求同步增长，测试设备 2026 年预计增长 31.0%至 153 亿美元，2028 年进一步增至 208 亿美元；封装设备 2026 年预计增长 9.6%至 67 亿美元，2028 年增至 86 亿美元。
 - 2) 分下游应用看，AI 算力需求持续拉动逻辑及存储设备投资。**代工及逻辑设备受 AI 加速器、高性能计算（HPC）及先进移动处理器需求驱动，2026 年销售额预计增长 18.9%至 780 亿美元，2028 年进一步增至 1047 亿美元；存储设备景气同步提升，其中 DRAM 设备受 HBM 需求及先进制程驱动，2026 年预计增长 39.0%至 388 亿美元，2028 年增至 569 亿美元；NAND 设备需求受 3D NAND 层数升级及高密度架构驱动，2026 年预计增长 30.7%至 139 亿美元，2028 年增至 208 亿美元
- **半导体设备厂商扩产及备货需求提升，核心零部件景气有望持续。**设备交付周期延长反映设备厂商在手订单保持充足。为保障交付能力，设备厂商通常会提前锁定关键零部件采购，并同步推进供应链备货及产能建设，上游核心零部件需求有望率先受益。同时，先进制程、HBM 及先进封装持续发展，高端设备对真空腔体、精密机械件、溅射靶材、陶瓷件等核心零部件的性能、精度及可靠性要求不断提升，推动高端零部件价值量持续增长；叠加国产替代不断推进，国内零部件企业有望同时受益于行业扩容与国产化率提升。**2026 年全年半导体设备厂商资本开支的高预期，正率先在今年上半年的零部件企业中报业绩中得到强力兑现。**富创精密预计 2026 年上半年实现归母净利润 1.20~1.50 亿元，同比增长 877.49%~1121.86%；富乐德预计实现归母净利润 1.82~2.22 亿元，同比增长 58.62%~93.51%；江丰电子预计实现归母净利润 4.80~5.60 亿元，同比增长 89.99%~121.65%。头部零部件企业业绩普遍保持高增长，表明设备景气正持续向上游核心零部件环节传导。在全球半导体资本开支持续增长、设备厂商订单保持高位及国产替代深入推进的背景下，核心零部件板块景气度有望持续。
- **投资建议：**我们建议关注两条投资主线。一是受益于设备厂商扩产备货及国产替代持续推进的核心零部件企业，重点关注**先锋精科（688605）、恒运昌（688785）**；二是受益于全球半导体资本开支持续增长，具备全球竞争力的半导体设备企业，建议关注**北方华创（002371）、中微公司（688012）、拓荆科技（688072）、盛美上海（688082）、精测电子（300567）**。
- **风险提示：**AI 算力投资及终端需求不及预期；全球晶圆厂扩产节奏低于预期；半导体设备厂商订单增长低于预期；核心零部件国产替代进程及客户导入不及预期。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归属爱

引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。